

CHINVAY

APPROVAL SHEET

CUSTOMER :

ITME : 手机 SIM 卡座

MODEL : SC-1.2-6C-2.58

MATERIEL NO:

DATE : 08/08/2007

APPROVED BY:

深圳市创宇伟业科技有限公司

地 址: 深圳市龙岗区葵冲镇奔康工业区 B-7 栋 3 楼

电 话: 0755-8977 3388 8312 0030

传 真: 0755-8312 0032 8977 5511

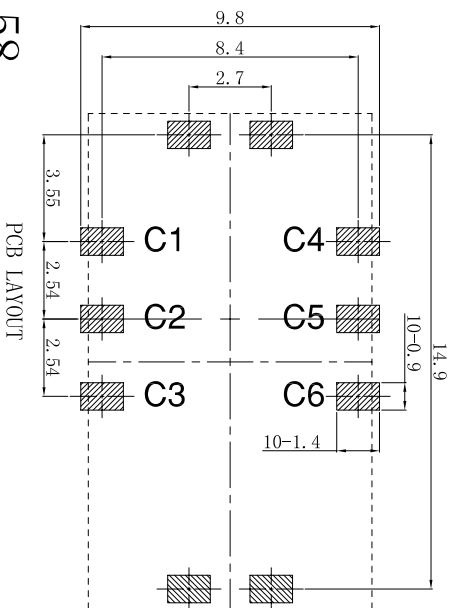
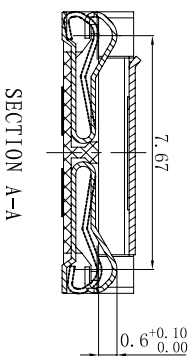
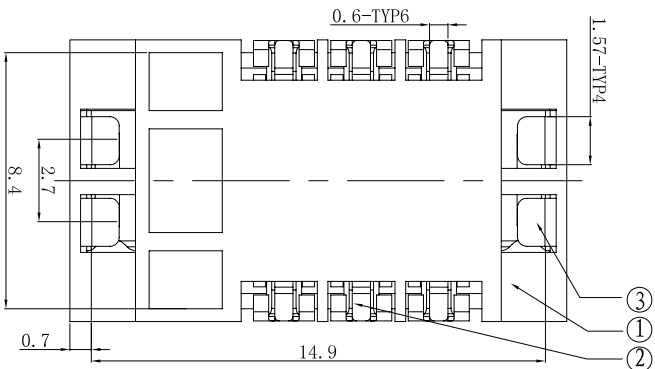
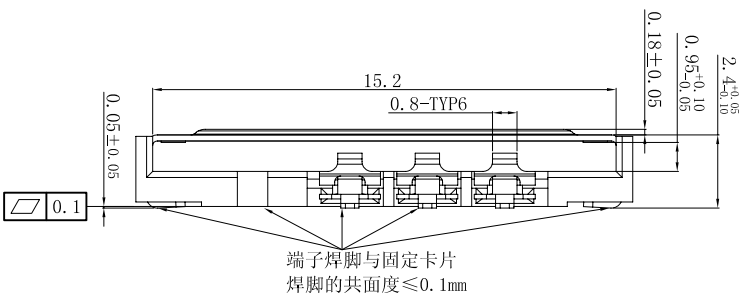
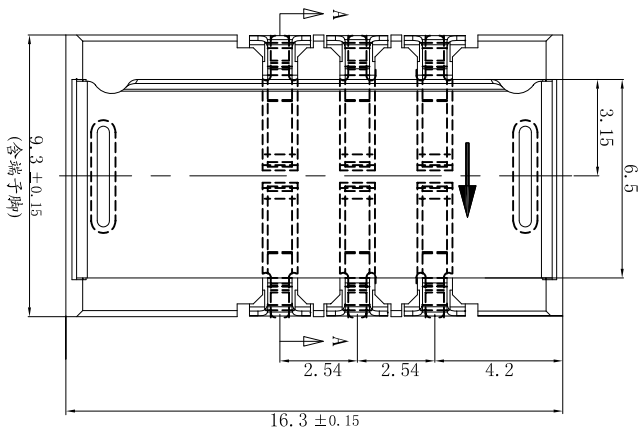
网 站: www.chinvay.com

阿里巴巴: cywy01.cn.alibaba.com

销售经理: 胡先生 手机: 136 0251 1930

邮 件 I: hkn@chinvay.com

邮 件 II: hukn999@163.com



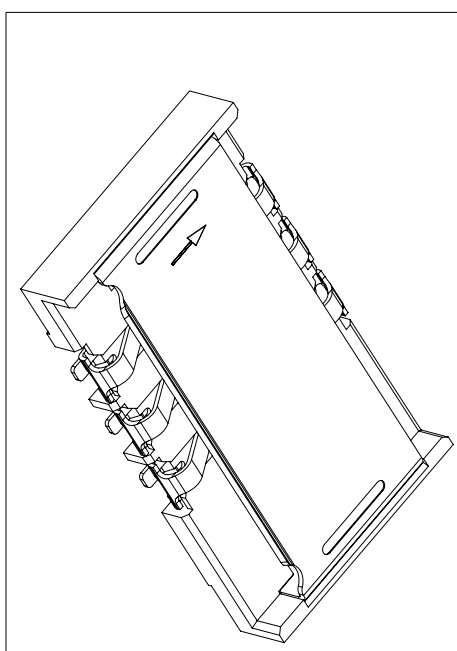
SC-1.2-6C-2.58

Sim card

Housing height

Position

Height



1. 电气性能
 - ▲ 接触电阻 初始 $\leq 30\text{m}\Omega$ 实验后 $\leq 50\text{m}\Omega$
 - ▲ 额定电压 30VAC/DC/MAX
 - ▲ 额定电流 0.5A/MAX
 - ▲ 耐电压 500VAC 最少承受一分钟
 - ▲ 绝缘电阻 $\geq 500\text{M}\Omega$ (500V测试)

2. 机械特性

▲ 触点正向压力: 端子正向压缩0.3mm后, 压力不小于30gf/pin

▲ 插拔寿命 插拔5000次后, 接触电阻增大不超过20mΩ

▲ 机械寿命 5000次

3. 工作温湿度 $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}/5 \sim 85\text{R.H.}$

4. 耐焊接热 焊接温度260°C时, 要求10s不变形

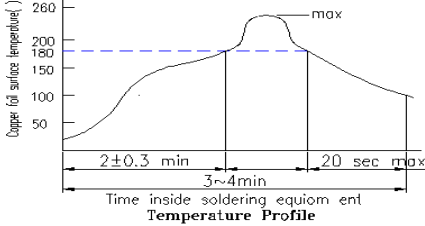
5. 产品符合ROHS标准, 采用载带包装, 每卷1000只。

3	外壳	1	不锈钢	载带
2	端子	6	磷铜, 镀金0.38um	
1	底座	1	LCP+30%GF, 黑色	
序号	名称	数量	材料, 表面处理	包装

深圳市创宇伟业科技有限公司

DIM	TOL	DIM	TOL	REV.	VO.0	APPROVAL:	DATE	TITLE: SIM CARD CONNECTOR
X		X	$\pm 2^\circ$					
X	± 0.10	X	$\pm 1^\circ$					P/N: SC-1.2-6C-2.58
.XX	± 0.05	.XX	$\pm 1^\circ$	CHECK:				SHEET: 1/1
.xxx	± 0.03	.xxx	$\pm 1^\circ$	REV.				SCALE: 1:1
				APPROVAL:				UNIT: mm

系列类型	WINGBLOCK CONNECTOR	编写 WRN BY:	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
型号	SC-1.2-6C-2.58	LI MING	ZHANG BO	WANG WEI
VERSION 版本:	V0.0			
DATE 日期:	2007.10.18	2007.10.16	2007.10.16	2007.10.18
1. SCOPE 适用范围 This specification covers the requirements for: “WINGBLOCK CONNECTOR” 本规格书适用: “WINGBLOCK CONNECTOR” 系列				
2. Rating 额定值: DC 30V 0.5A				
3. CONSTRUCTION 构造				
3.1 Shape and dimensions are subject to drawing. 形状.尺寸根据图面确定.				
3.2 All part not allowed to exist rust 、 crack and poor planting.各部分无生锈、裂痕、电镀不良现象.				
4. Standard test conditions shall be 5 to 35℃ in temperature and 45 TO 85% in humidity. 温度 5~35℃ , 湿度 45~85% 标准状态下测试.				
Item 项目	Test condition 测试条件		Performance 规格	
5. Electronical performance 电气性能				
5.1	Contact resistance 接触阻抗	Being measured at 1 KHz small current contact resistance meter. 在1kHz 小电流下测量。	30mΩ max. 30 毫欧 以下。	
5.2	Insulation resistance 绝缘阻抗	Measurements shall be made following application of DC 500 V potential across terminals and across terminals and frame for 1 minute. 在端子之间和端子与壳之间加 DC 500 V 条件下,持续 1 分钟测量。	500MΩ min. 500 兆欧 以上。	
5.3	Withstand voltage 耐压	AC 500 V(50Hz or 60 Hz)shall be applied across terminals and across terminals and frame for one minute. 在端子之间和端子与壳之间加 AC 500 V (50Hz 或 60Hz)条件下,持续 1 分钟测量。	There shall be no breakdown 无击穿现象出现.	
6. Mechanical performance 机械性能				
6.1	Operating force 接触压力		40gf MIN 40gf 以上	
6.2	Range 使用温度范围	在-20~+60℃温度内使用		
7. Durability 耐久性				
7.1	Lift test 寿命试验	5,000 cycles of operation at a rate of 15-18 cycles per minute with unloading 在无负载条件下,以每分钟 15-18 次的速度操作 5,000 次。	(1) Contact resistance 接触阻抗 200mΩ max.200 毫欧 以下 (2) 其它满足机械,电器性能.	
7.2	Heat test 耐热试验	85±2℃ for 96 hours, test after keeping in normal condition for 60 minutes. 在 85±2℃环境中放 96 小时, 再放在正常环境中, 60 分钟后进行测试。	Insulation resistance 50MΩ min.50 兆欧以上, 其它满足机械,电器性能.	

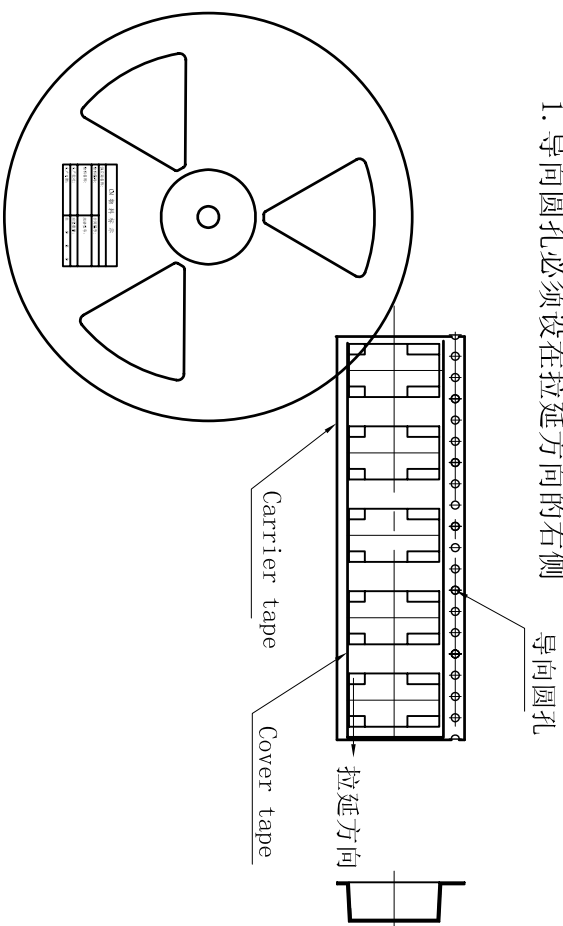
7.3	Humidity test 耐湿试验	40±2℃ 90-95%RH for 96 hours, test after keeping in normal condition for 60 min. 在 40±2℃ 90—95% RH 环境中放 96 小时, 再放在正常环境中, 60 分钟后进行测试。	Insulation resistance 50MΩ min.50 兆欧以上, 其它满足机械, 电器性能.
7.4	Cold test 耐冷试验	At -25±3℃ for 96 hours, test after keeping in normal condition for 60 min. 在 -25±3℃ 环境中放 96 小时, 再放在正常环境中, 60 分钟后进行测试。	There shall be no sign of damage mechanically and electrically 无任何迹象显示机械及电气性能损坏。
7.5	Resistance to soldering heat test 耐焊性试验	<p>soldering iron method: Bit temperature 350±10℃ application time 3±0.5 sec application time 3±0.5 sec. However excessive pressure shall not be applied to the terminal. 手焊接的时候温度需控制在 350±10℃, 时间为 3±0.5 秒, 不能在排脚上施加异常压力。</p> <p>Reflow Soldering Conditions: Preheat: Temperature on the copper foil surface should reach 180℃. 2±0.3 minutes after the P.W.B entered into the soldering equipment. Soldering heat: Temperature on the copper foil surface should reach the peak temperature of 240±5℃ within 20 seconds after the P.W.B enter into soldering heat zone.</p> <p>过回流焊条件: 预热: 电镀层表面的温度应达到 180℃, 2±0.3 分钟, 后电路板进入回流焊设备. 回流焊温度: 电镀层表面温度最高为 260±5℃ 且停留不超过 10 秒后电路板进入低温焊接处.</p>  <p style="text-align: center;">Temperature Profile</p>	Without deformation of case or excessive looseness of terminals electrical characteristics shall be satisfied. 本体无变形, 能满足于机械、电气性能。

PACKAGING SPECIFICATION

REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
V0.0			初版发行		

内盒包装方式

- (1) 每个盘包装方式如图一所示。
 - (2) 在开始缠绕料带时，取长60mm之纸胶带一段，20mm粘于料带上，40mm粘于REEL芯轴之缺口上，如图二所示。
 - (3) 料带卷绕完成时取长60mm之纸胶带粘住COVER TAPE并将其固定在REEL之圆周上。
- * COVER TAPE有中断时可用宽18mm，长40mm之胶带将中断之两端各贴20mm，使其连接为一体。但连接后的两段COVER TAPE应在同一直线上。



1. 导向圆孔必须设在拉延方向的右侧

导向圆孔

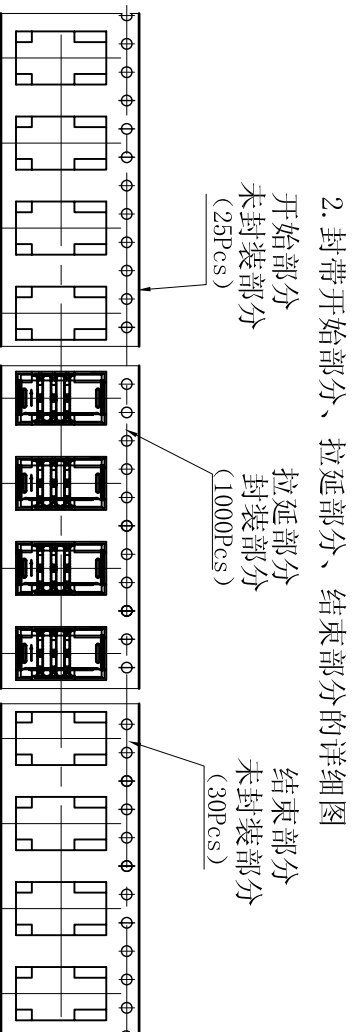
拉延方向

Carrier tape

Cover tape

外箱包装方式

- (1) 纸箱—Pcs。
- (2) 防水袋2Pcs。
- (3) 各叠好5个Reel（共10个）分别放入防水袋中，然后封上防水袋，放入纸箱中。
- (4) 将外箱上层封口。



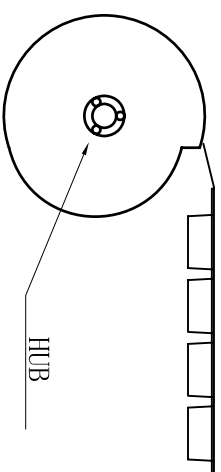
2. 封带开始部分、拉延部分、结束部分的详细图

开始部分
未封装部分
(25Pcs)

拉延部分
封装部分
(1000Pcs)

结束部分
未封装部分
(30Pcs)

(图一)



(图二)

		深圳市创宇伟业科技有限公司	
QUANTY	FILE NO.	DATE	TITLE: SIM CARD CONNECTOR
DRAW NO.	DESIGN:		P/N: SC-1.2-6C-2.58
REV.	CHECK:		SHEET: 1/1
V0.0	APPROVAL:		SCALE: 1:1 UNIT: mm